

製品仕様一覧

製品名称		MAGNIA R3520e					
形名		/s	/e	/l8	/l12		
形番		TN8100-2562T	TN8100-2563T	TN8100-2564T	TN8100-2565T		
CPU	対応 CPU	インテル® Xeon® プロセッサ Bronze 3104(6C/6T, 1.70 GHz, 8.25MB, TDP 85W), Bronze 3106(8C/8T, 1.70 GHz, 11MB, TDP 85W), Silver 4108(8C/16T, 1.80 GHz, 11MB, TDP 85W), Silver 4110(8C/16T, 2.10 GHz, 11MB, TDP 85W), Silver 4112(4C/8T, 2.60 GHz, 8.25MB, TDP 85W), Silver 4114(10C/20T, 2.20 GHz, 13.75MB, TDP 85W), Silver 4116(12C/24T, 2.10 GHz, 16.50MB, TDP 85W), Gold 5115(10C/20T, 2.40 GHz, 13.75MB, TDP 85W), Gold 5118(12C/24T, 2.30 GHz, 16.50MB, TDP 105W), Gold 5120(14C/28T, 2.20 GHz, 19.25MB, TDP 105W), Gold 5122(4C/8T, 3.60 GHz, 16.50MB, TDP 105W), Gold 6126(12C/24T, 2.60 GHz, 19.25MB, TDP 125W), Gold 6128(6C/12T, 3.40 GHz, 19.25MB, TDP 115W), Gold 6130(16C/32T, 2.10 GHz, 22MB, TDP 125W), Gold 6132(14C/28T, 2.60 GHz, 19.25MB, TDP 140W), Gold 6134(8C/16T, 3.20 GHz, 24.75MB, TDP 130W), Gold 6136(12C/24T, 3 GHz, 24.75MB, TDP 150W), Gold 6138(20C/40T, 2GHz, 27.50MB, TDP 125W), Gold 6140(18C/36T, 2.30 GHz, 24.75MB, TDP 140W), Gold 6142(16C/32T, 2.60 GHz, 22MB, TDP 150W), Gold 6144(8C/16T, 3.50 GHz, 24.75MB, TDP 150W), Gold 6146(12C/24T, 3.20 GHz, 24.75MB, TDP 165W), Gold 6148(20C/40T, 2.40 GHz, 27.50MB, TDP 150W), Gold 6150(18C/36T, 2.70 GHz, 24.75MB, TDP 165W), Gold 6152(22C/44T, 2.10 GHz, 30.25MB, TDP 140W), Gold 6154(18C/36T, 3GHz, 24.75MB, TDP 200W), Platinum 8153(16C/32T, 2 GHz, 22MB, TDP 125W), Platinum 8156(4C/8T, 3.60 GHz, 16.50MB, TDP 105W), Platinum 8158(12C/24T, 3GHz, 24.75MB, TDP 150W), Platinum 8160(24C/48T, 2.10 GHz, 33MB, TDP 150W), Platinum 8164(26C/52T, 2GHz, 35.75MB, TDP 150W), Platinum 8168(24C/48T, 2.70 GHz, 33MB, TDP 205W), Platinum 8170(26C/52T, 2.10 GHz, 35.75MB, TDP 165W), Platinum 8176(28C/56T, 2.10 GHz, 38.50MB, TDP 165W), Platinum 8180(28C/56T, 2.50 GHz, 38.50MB, TDP 205W), Gold 6134M(8C/16T, 3.20GHz, 24.75MB, TDP 130W), Gold 6140M(18C/36T, 2.30 GHz, 24.75MB, TDP 140W), Gold 6142M(16C/32T, 2.60 GHz, 22MB, TDP 150W), Platinum 8160M(24C/48T, 2.10 GHz, 33MB, TDP 150W), Platinum 8170M(26C/52T, 2.10 GHz, 35.75MB, TDP 165W), Platinum 8176M(28C/56T, 2.10 GHz, 38.50MB, TDP 165W), Platinum 8180M(28C/56T, 2.50 GHz, 38.50MB, TDP 205W)					
	標準搭載数 / 最大搭載数	0/2					
	コントローラー・ハブとの接続	DMI3 (8GB/s)					
	インテル®バーチャライゼーション・テクノロジー	対応					
	インテル®ハイパー・スレッディング・テクノロジー	対応 (Xeon Bronze 3104/3106 は除く)					
	インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー	対応 (Xeon Bronze 3104/3106 は除く)					
チップセット		インテル® C621 チップセット					
メモリ	搭載容量 標準 / 最大	標準搭載なし(セレクトラブルオプション) / Registered DIMM : 768GB (24x 32GB), Load Reduced DIMM : 3TB (24x 128GB)					
	搭載メモリ	DDR4-2666 Registered DIMM (8/16/32GB), DDR4-2666 Load Reduced DIMM (64/128GB)					
	最大動作周波数	2666MHz (CPU 毎の最大動作周波数はシステム構成ガイドを参照願います)					
	誤り検出・訂正	ECC, x4 SDDC					
	メモリスベアリング	対応					
	メモリミラーリング	対応					
補助記憶装置	ドライブベイ	内蔵スロット	フロント	8x 2.5 型ドライブ, 8x 2.5 型ドライブ (オプション 最大 1 個), 2x 2.5 型ドライブ (オプション 最大 1 個)	24x 2.5 型ドライブ	8x 3.5 型ドライブ, 2x 2.5 型ドライブ (オプション 最大 1 個)	12x 3.5 型ドライブ
			ミドル	-		4x 3.5 型ドライブ(オプション 最大 1 個)	
			リア	2x 2.5 型ドライブ(オプション 最大 3 個)		2x 2.5 型ドライブ(オプション 最大 1 個), 3x 3.5 型ドライブ(オプション 最大 1 個)	
			内部	2x M.2 SATA スロット(オプション)			

		内蔵標準	-			
		内蔵最大	2.5 型 HDD: SATA 48TB (24x 2TB), SAS 43.2TB (24x 1.8TB) 2.5 型 SSD: SATA 92.16TB (24x 3.84TB), SAS 23.04TB (24x 960GB) (オプション HDD ケージ追加時)	2.5 型 HDD: SATA 60TB (30x 2TB), SAS 54TB (30x 1.8TB) 2.5 型 SSD: SATA 115.2TB (30x 3.84TB), SAS 28.8TB (30x 960GB) (オプション HDD ケージ追加時)	3.5 型 HDD: SATA 150TB (15x 10TB), ニアライン SAS 150TB(15x 10TB)、 + 2.5 型 HDD: SATA 8TB (4x 2TB), SAS 7.2TB(4x 1.8TB) 2.5 型 SSD: SATA 15.36TB (4x 3.84TB), SAS 3.84TB (4x 960GB) (オプション HDD ケージ追加時)	3.5 型 HDD: SATA 190TB(19x 10TB), ニアライン SAS 190TB(19x 10TB) + 2.5 型 HDD: SATA 4TB (2x 2TB) SAS 3.6TB(2x 1.8TB) 2.5 型 SSD: SATA 7.68TB (2x 3.84TB), SAS 1.92TB (2x 960GB) (オプション HDD ケージ追加時)
		ホットスワップ	対応(内部ドライブを除く)			
		インターフェース規格と RAID 構成	SATA 6Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション), SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション)			
		光ディスクドライブ	内蔵/外付ドライブ接続 (オプション)*1			
		FDD	オプション: Flash FDD (1.44MB)*2			
		拡張ベイ	-			
		拡張スロット	標準構成 1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (フルハイト、フルレンジ) 1x PCI Express 3.0 (x16 レーン, x16 ソケット) (フルハイト、フルレンジ) 1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (フルハイト、ハーフレンジ) 1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (RAID コントローラ専用) 1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (LOM カード専用) (オプションのライザカードを手配することで PCI 構成を変更可能です。詳細はシステム構成ガイドを参照ください。)			
グラフィック	搭載チップ / ビデオ RAM	マネージメントコントローラチップ内蔵 / 16MB				
ス	グラフィック表示 と 解像度	640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,200				
標準インターフェース	フロント	1x USB3.0(Type A)*3, 1x USB2.0(Type A) (BMC 用)	1x USB3.0(Type A), 1x USB2.0(Type A) (BMC 用) 1x ディスプレイポート	-		
	リア	2x USB3.0 (TypeA), 1x アナログ RGB (ミニ D-Sub15 ピン), 1x マネージメント専用 LAN コネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応, RJ-45) 4x データ LAN コネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応 (RJ-45)) 1x シリアルポート (オプション)				
	内部	2x USB3.0 (TypeA), 2x SATA 2.0 Port				
キーボード・マウス		オプション				
冗長電源		対応 (オプション, ホットプラグ可)				
冗長ファン		対応 (標準, ホットプラグ可)				
外形寸法 (幅 x 奥行き x 高さ)		445.5mm x 679.4mm x 87.3mm (2.5 型ドライブモデル : フロントベゼル/レール/突起物含まず) 445.5mm x 730.2mm x 87.3mm (3.5 型ドライブモデル : フロントベゼル/レール/突起物含まず)				
質量 (最小 / 最大)		15kg / 38kg	15kg / 39kg	15kg / 45kg	15kg / 46kg	
電源		選択必須オプション AC 電源ユニット(TN8181-159T, 160T) 500W/800W 80 PLUS® Platinum 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC100V/200V±10%, 50/60Hz±3Hz(1xAC200V 用電源ケーブル(ケーブル長: 2m, プラグ形状: IEC320 C14)付属) AC 電源ユニット(TN8181-161T, 162T) 800W 80 PLUS® Titanium/1600W 80 PLUS® Platinum 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC200V±10%, 50/60Hz±3Hz(1xAC200V 用電源ケーブル(ケーブル長: 2m, プラグ形状: IEC320 C14)付属)				
消費電力(100V 最大構成時, 最大電力)		908VA/899W(800W 電源最大時)				
消費電力(200V 最大構成時, 最大電力)		1271VA/1270W*4	1329VA/1326W*4	1217VA/1217W*4	1247VA/1244W*4	
省エネ法(2011 年度基準)に基づくエネルギー消費効率 (W/GTOPS) *5		対象外 *6				

音量	音圧レベル(100V 最大構成時、高負荷時)	34dB
温度/湿度条件		動作時: 10~35°C, 保管時: -30~60°C/ 動作時: 8~90%, 保管時: 5~95% (動作時/保管時ともに結露しないこと)
主な添付品		スタートアップガイド, 保証書, フロントベゼル
対応 OS	Windows	Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter
	Linux	Red Hat® Enterprise Linux® 7.3 以降
	VMware	VMware ESXi™ 6.0 Update3, VMware ESXi™ 6.5 Update1

*1: 内蔵光ディスクドライブをシステムに搭載しない場合、保守時および OS 再インストール時に備えて外付ディスクドライブを全システムで最低 1 式は必ず手配してください。

*2: 必要に応じて購入してください。主な用途については構成ガイドを参照下さい。

*3: VMware ESXi 6.0 をインストールした場合、USB2.0 で動作します。

*4: CPU TDP ごとの最大電力はシステム構成ガイドをご参照ください。

*5: 省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネルギー法で定める複合理論性能(単位: ギガ演算)で除したものです。

*6 省エネ法(2011 年度目標基準)の規制対象外です。

製品環境諸元一覧

国際エネルギー効率計画基準への適合 (Y/N)	適合予定			
低電力モード消費電力(W)	241	242	245	241
グリーン購入法特記事項(2015年2月閣議決定)	対象外			
省エネ法関連特記事項	省エネ法規制対象外 *6			
リサイクル設計 (Y/N)	Y			
再生プラスチック材料使用	再生プラスチック材の使用 (Y/N)	N		
	使用箇所	-		
リサイクル関連特記事項	25g以上の本体樹脂部品の一部に材料表示			
取扱説明書における再生紙使用 (Y/N)	- (紙媒体の添付無し)			
特定臭素系難燃剤(PBBs, PBDDOs, (PBDEs))の不使用 (Y/N)	Y			
塩ビ(PVC)の不使用 (Y/N)	N			
梱包材への発泡剤の不使用 (Y/N)	N			
梱包材へのPVCの不使用 (Y/N)	Y			

*6: 200GTOPS を超えるため省エネ法(2011年度目標基準)規制対象外です。